

FEL ČVUT prezentovala své čipové projekty na Taiwan-Europe Chip Innovation Forum v Drážďanech

4.12.2025 - | Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

Přibližně třicet studentů a výzkumníků z katedry mikroelektroniky FEL ČVUT se na konci listopadu zúčastnilo prestižního Taiwan-Europe Chip Innovation Forum (TECIF) v Drážďanech. Akce, která patří k nejvýznamnějším evropsko-tchajwanským setkáním v oblasti návrhu a vývoje čipů, letos přilákala kolem 300 odborníků z akademické i průmyslové sféry. Za FEL ČVUT zde zazněly hned tři přednášky a pět společných česko-tchajwanských projektů bylo představeno formou posterů.

Silná prezentace FEL ČVUT po boku špiček z Evropy i Tchaj-wanu

Za FEL vystoupili prof. Jiří Jakovenko, dr. Vladimír Janíček, dr. Dalibor Barri a Ing. Jiří Maier v odborných sekcích věnovaných návrhu integrovaných obvodů, metodám založeným na strojovém učení pro backend design a výsledkům česko-tchajwanských výzkumných projektů v rámci CTU TSRI Joint Research Centre. Prezentovány byly také všechny aktuální společné projekty FEL a tchajwanských univerzit, které se věnují pokročilým návrhovým metodám, layoutu čipů či novým hybridním technologiím.

Účast na akci byla o to cennější, že hlavními partnery fóra byly instituce TSRI, imec a EURORACTICE, tedy organizace, které definují další směřování evropského a tchajwanského polovodičového výzkumu. Naši výzkumníci tak představili projektové výsledky po boku těch nejvýznamnějších aktérů oboru.

Motivace pro studenty: Evropa jako silný globální partner v čipových technologiích

Studenti FEL ČVUT, převážně z magisterského programu Elektronika a komunikace se specializací na mikroelektroniku, hodnotili účast velmi pozitivně. Akce jim nabídla inspiraci i lepší představu o tom, jak dynamicky se rozvíjí oblast návrhu čipů nejen ve světě, ale i v Evropě. Dozvěděli se také o probíhající výstavbě nové továrny tchajwanské společnosti TSMC v Drážďanech nebo o plánech na posílení evropské čipové soběstačnosti. Měli tak možnost se setkat s výrobcí, vývojáři a partnery, kteří formují budoucnost čipového průmyslu v Evropě.

„Naši studenti se na TECIF mohli přesvědčit, že návrh čipů je téma, které rezonuje napříč kontinenty a že bez inovací v čipových technologiích by neexistovaly žádné inovace v dalších technických a počítačových oborech. Pro mnoho z nich byla účast na této akci silně motivující – potvrzení, že to, co studují, má obrovský význam pro budoucnost evropského technologického průmyslu,“ říká prof. Jiří Jakovenko.

Pokračování úspěšné spolupráce s Tchaj-wanem

FEL ČVUT je dlouhodobě aktivním partnerem tchajwanských univerzit a výzkumných institucí. Letos otevřené CTU TSRI Joint Research Centre propojuje české a tchajwanské týmy při vývoji nových čipů a návrhových metod. Společné projekty i odborné akce, jako jsou letní školy a mezinárodní workshopy, přispívají k rychlému růstu českého know-how v oblasti mikroelektroniky.

„Spolupráce s tchajwanskými partnery je pro nás strategická. Fórum TECIF znovu ukázalo, že

společné projekty přinášejí reálné výsledky a vytvářejí prostor pro další propojení evropského a asijského ekosystému v oblasti polovodičů,” doplňuje dr. Vladimír Janíček.

Forum TECIF má navíc symbolický přesah pro FEL ČVUT – jeho první ročník se konal v roce 2024 v Praze, kde fakulta vystupovala jako hlavní akademický partner. Úspěch pražské akce stál u zrodu tradice, která nyní pokračuje v dalších evropských městech.

<https://fel.cvut.cz/cs/aktualne/novinky/82691-fel-cvut-prezentovala-sve-cipove-projekty-na-taiwan-europe-chip-innovation-forum-v-drazdanech>